

2022年3月期 決算説明会

2022年6月10日

株式会社フジミインコーポレーテッド

サイバー攻撃への対応に関して

この度の不正アクセスに伴い、お取引先、株主・投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことをあらためて深くお詫び申し上げます。

（発生経緯と復旧状況）

- 2022年2月20日：当社および子会社フジミ台湾でサイバー攻撃を確認。直ちにホームページおよびネットワーク含め社内システムを停止し、一部の生産と出荷を見合わせ
- 3月第一週：生産、出荷を段階的に再開
- 3月下旬：生産、出荷数ともにほぼ平常水準に復旧
- 5月31日：当初予定より2週間遅れて決算発表

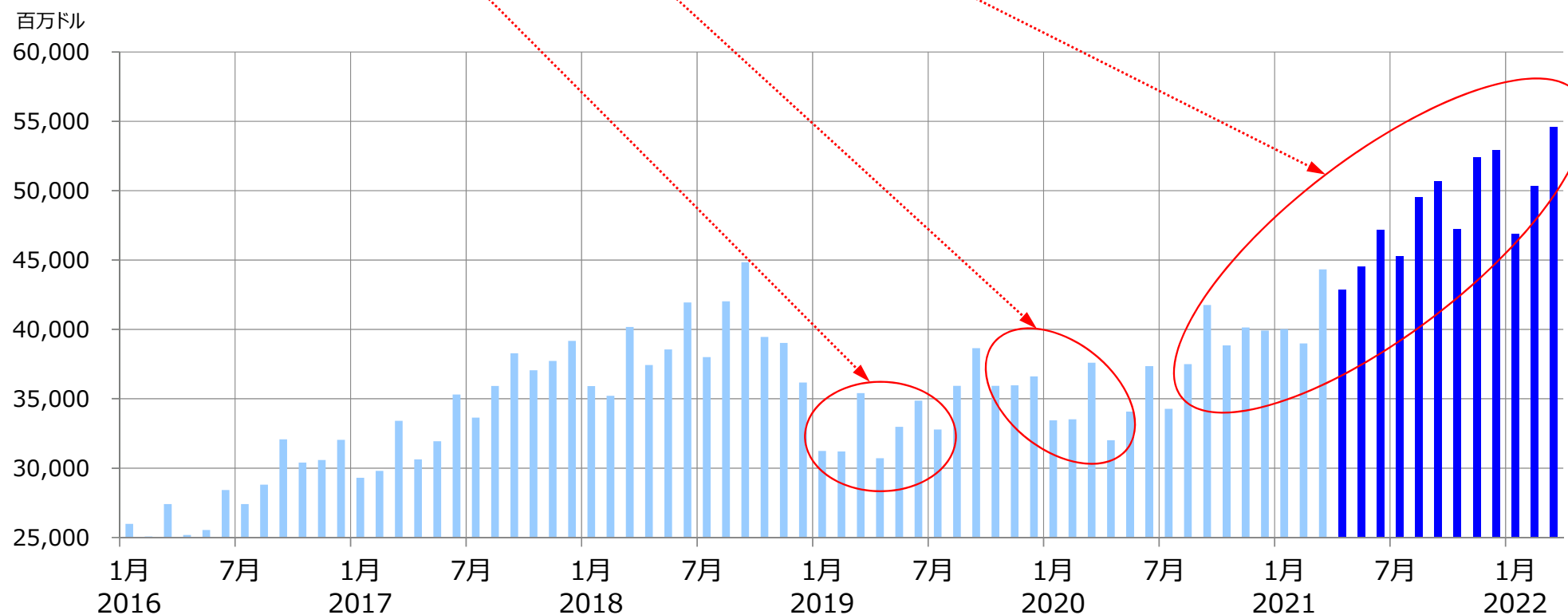
（発生原因と対策）

- 一部通信機材の脆弱性を突かれたことが原因だったが、問題となった脆弱性については海外拠点を含めた対応を完了
- 再発防止に向けたセキュリティ（24時間外部監視体制等を含む）を強化中
- 社内の情報セキュリティ管理体制を拡充し、再発防止策の強化を継続して実施する

市場概況

世界半導体市場動向（月次 実績 ※2022年3月まで）

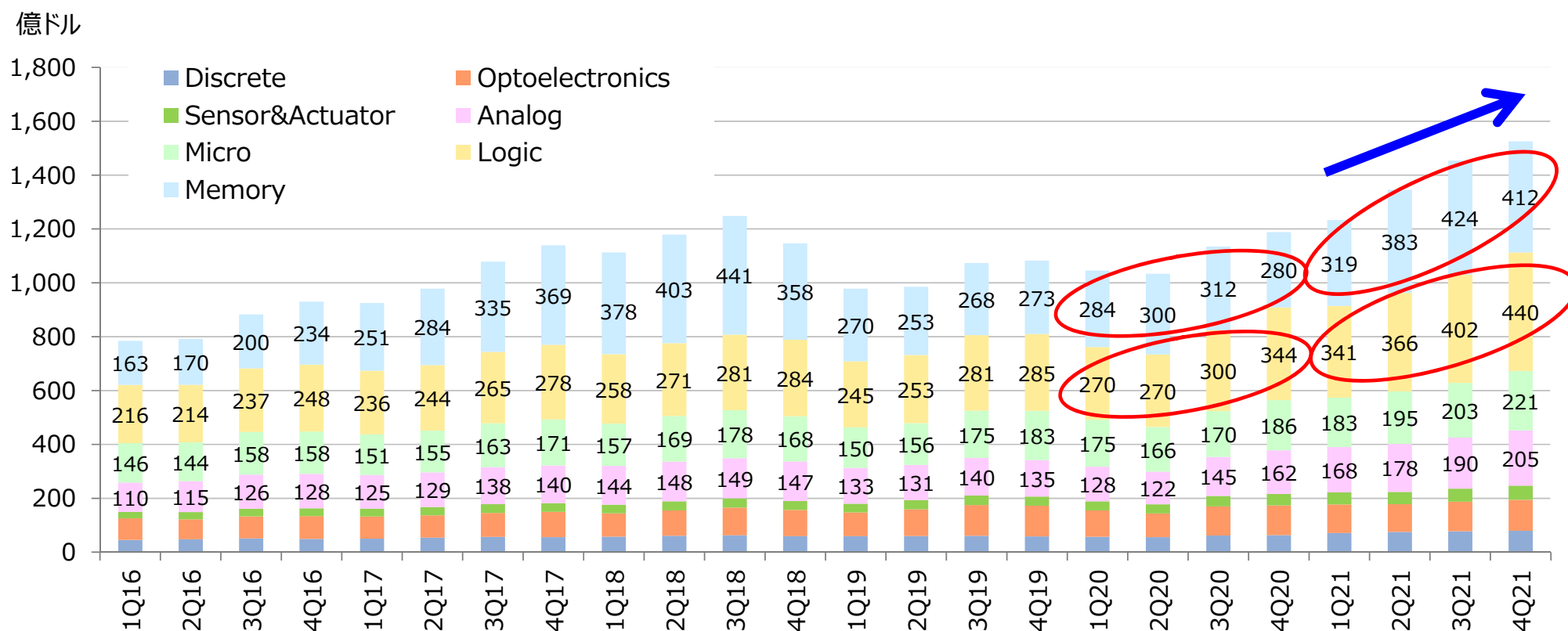
- 2019年1月から7月までの半年ほど、メモリバブルの反動で低迷後、北米、中国を中心に回復
- 2020年1月より、新型コロナの影響で再び下降、同年4月で底打ち
- 2020年8月以降、上昇に転じた後、非常に強い半導体需要が現在も継続



出所：WSTS

世界半導体市場動向（四半期 実績） 用途別

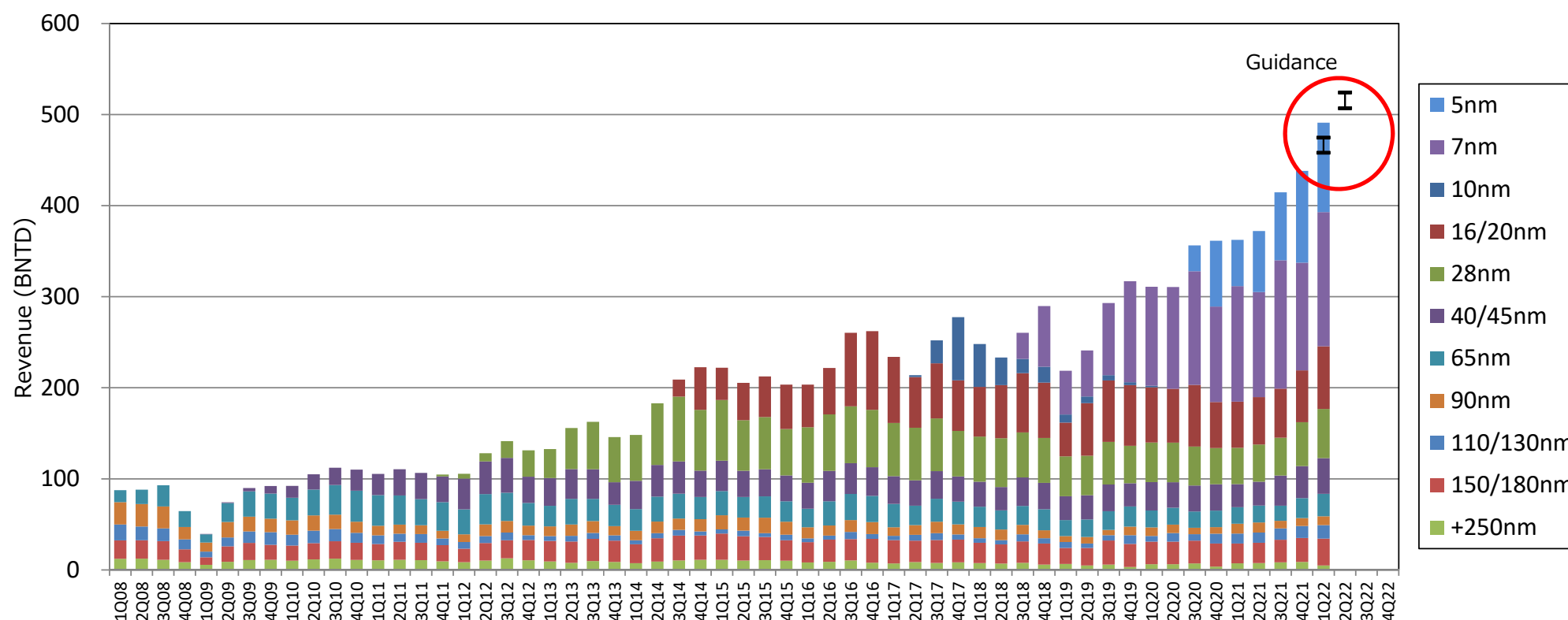
・2021年の世界半導体市場は、ロジック・メモリともに前年比+30%の大幅伸長



出所：WSTS

台湾セミコンダクター（TSMC）売上高（2022年1-3月期）

- 2021年の売上高は、四半期毎に過去最高を更新
- 2022年1Q（1-3月期）も引き続き過去最高を更新し、2Q（4-6月期）も過去最高を更新見込（ガイダンスベース）
- Node別売上高では5nm, 7nmの最先端半導体デバイス向けだけでなく、28nm以前の従来型向けも増加

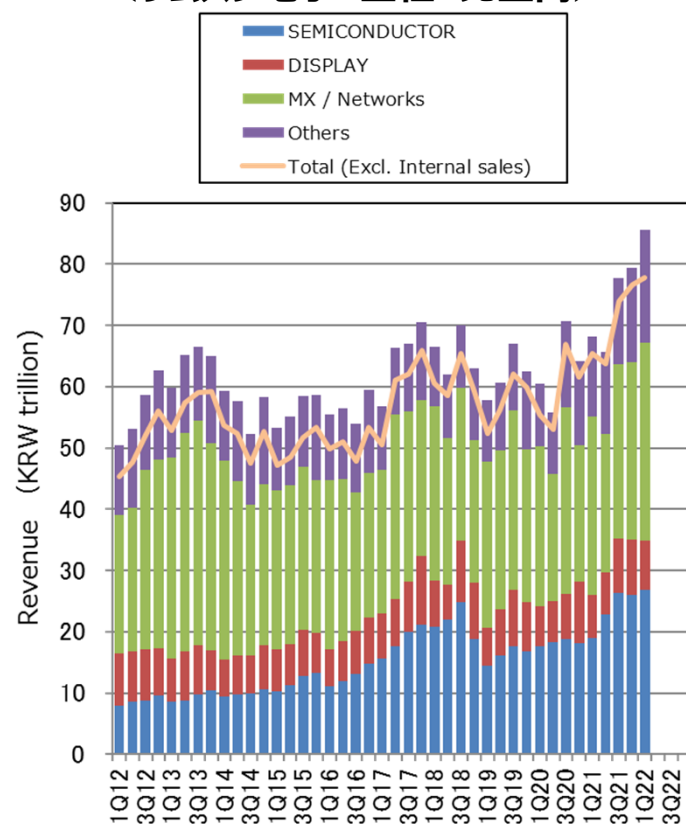


出所：TSMC公開情報よりフジミ作成

サムスン電子 売上高（2022年1-3月期）

- 半導体事業は、2021年3Q（7-9月期）売上高が過去最高を更新した後も、同4Q（10-12月期）、2022年1Q（1-3月期）と高水準で推移
- DRAM、NANDともにサーバー向け等で堅調

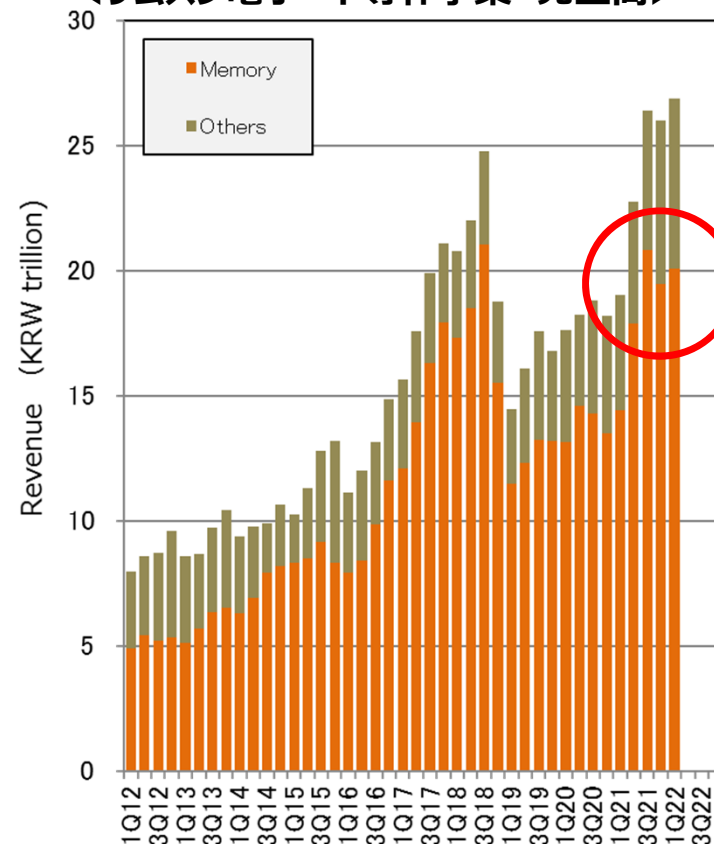
＜サムスン電子 全社 売上高＞



出所：サムスン電子公開情報よりフジミ作成

Copyright(c) 2022 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

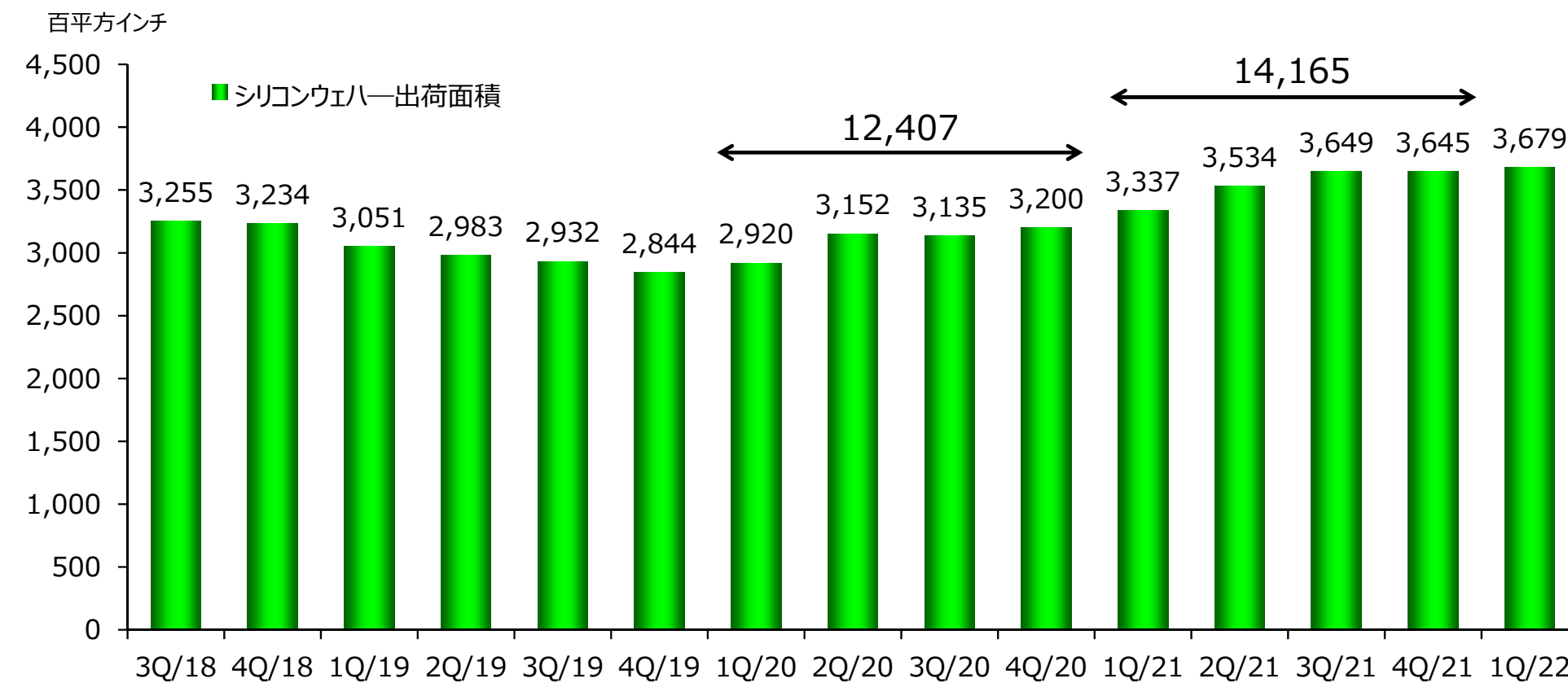
＜サムスン電子 半導体事業 売上高＞



《暦年ベース》

シリコンウェハー出荷面積（四半期）

・2021年のシリコンウェハー出荷面積は前年比+14.2%

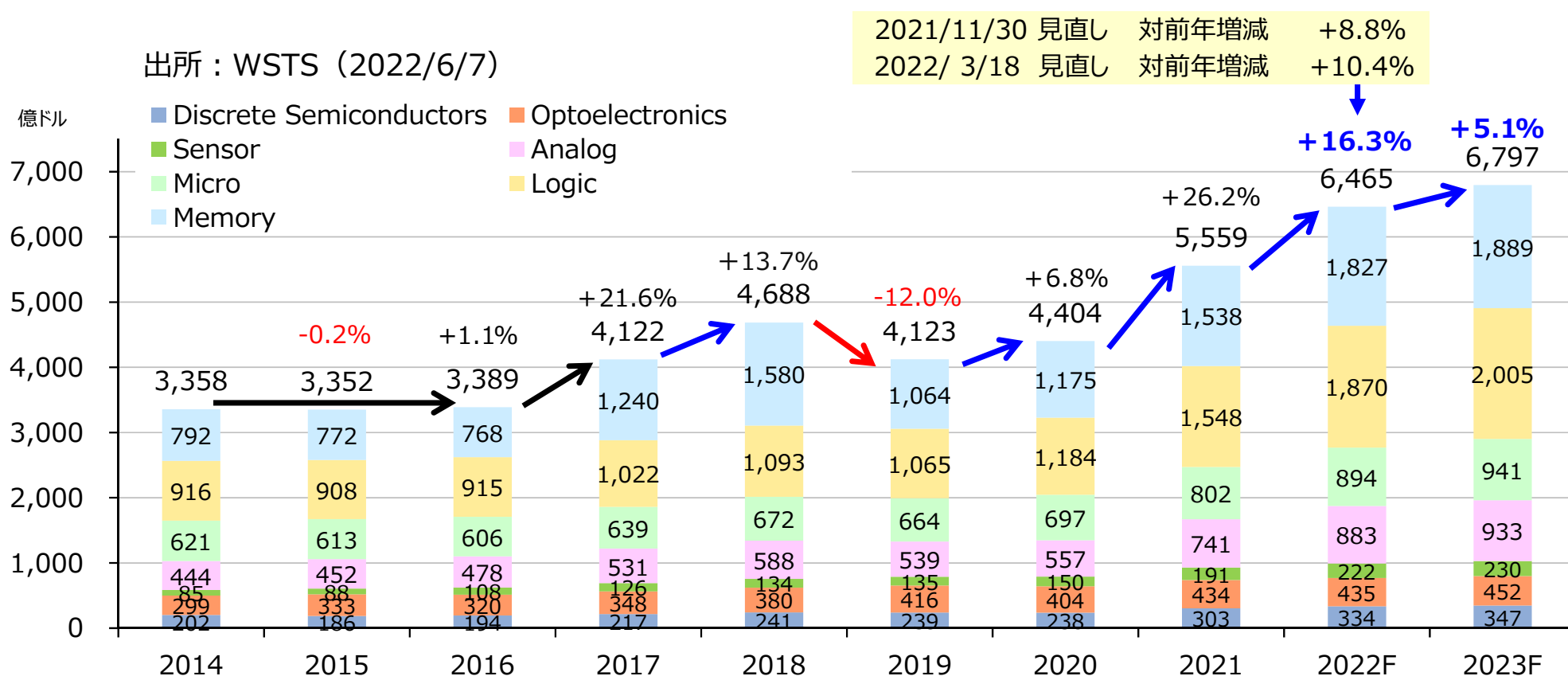


出所：SEMI（2022/5/9）

《暦年ベース》

世界半導体市場動向（年次 WSTS予測） 用途別

- 2022年予測では、新型コロナウイルスや地政学的リスクに伴う不透明要素はあるものの、半導体の潜在的な需要の強さを反映し、**+16.3%** と見込まれている
(通信インフラやデータセンタ関連投資により、2022年のメモリの予測を大幅上方修正 +1.1% (3/18) ➡ +18.7% (6/7))
- 2023年予測では、世界景気の更なる回復に加え、半導体需要の裾野拡大が期待されることから、**+5.1%** の成長が見込まれている



決算概要

決算概要（通期実績）

単位：百万円	21年3月期	22年3月期					
	通期実績	期初予想 ('21/5)	修正予想 ('22/2)	通期実績	前期比	期初予想比 ('21/5)	修正予想比 ('22/2)
売上高	41,956	43,500	51,500	51,731	+23.3%	+18.9%	+0.4%
営業利益	7,639	8,500	12,000	12,059	+57.9%	+41.9%	+0.5%
率	18.2%	19.5%	23.3%	23.3%	-	-	-
経常利益	7,709	8,600	12,200	12,490	+62.0%	+45.2%	+2.4%
率	18.4%	19.8%	23.7%	24.1%	-	-	-
当期純利益	5,607	6,200	9,100	9,156	+63.3%	+47.7%	+0.6%
率	13.4%	14.3%	17.7%	17.7%	-	-	-

（前期比）

- ・最先端半導体デバイス向けCMP製品・シリコンウェハー向け製品の販売好調により、大幅増収増益
- ・営業利益・経常利益は3期、当期純利益は4期連続で過去最高を更新

決算概要（半期実績）

単位：百万円	21年3月期		22年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	前年同期比	前年下期比	下期実績	前年同期比	同年上期比
売上高	20,427	21,529	25,291	+23.8%	+17.5%	26,439	+22.8%	+4.5%
営業利益	3,718	3,920	6,158	+65.6%	+57.1%	5,900	+50.5%	△4.2%
率	18.2%	18.2%	24.4%	-	-	22.3%	-	-
経常利益	3,694	4,015	6,357	+72.1%	+58.3%	6,133	+52.8%	△3.5%
率	18.1%	18.7%	25.1%	-	-	23.2%	-	-
四半期純利益	2,855	2,752	4,803	+68.2%	+74.5%	4,353	+58.1%	△9.4%
率	14.0%	12.8%	19.0%	-	-	16.5%	-	-

下期実績

（前期同期比）・最先端半導体デバイス向けCMP製品・シリコンウェハ向け製品の販売好調により、大幅増収増益

（同年上期比）・堅調な半導体需要を背景に増収も、原材料価格の高騰、物流費の増加、サイバー関連による費用増

業績予想（通期）

単位：百万円	21年3月期	22年3月期	23年3月期	
	通期実績	通期実績	通期予想	前年比
売上高	41,956	51,731	58,000	+12.1%
営業利益 率	7,639 18.2%	12,059 23.3%	13,500 23.3%	+11.9% -
経常利益 率	7,709 18.4%	12,490 24.1%	13,600 23.4%	+8.9% -
当期純利益 率	5,607 13.4%	9,156 17.7%	10,000 17.2%	+9.2% -

・増収増益予想（売上高、営業利益、経常利益、当期純利益ともに、過去最高の更新を見込む）

・想定為替レート：120円／ドル（前期実績：112円／ドル）

・売上高：半導体市場の好調に伴う最先端半導体デバイス向けCMP製品・シリコンウェハー向け製品の販売増加に加え円安の影響もあり、増収を見込む

・利益：増収に伴い増益となるも、経費増・原材料価格高騰により、営業利益率は前期水準を維持

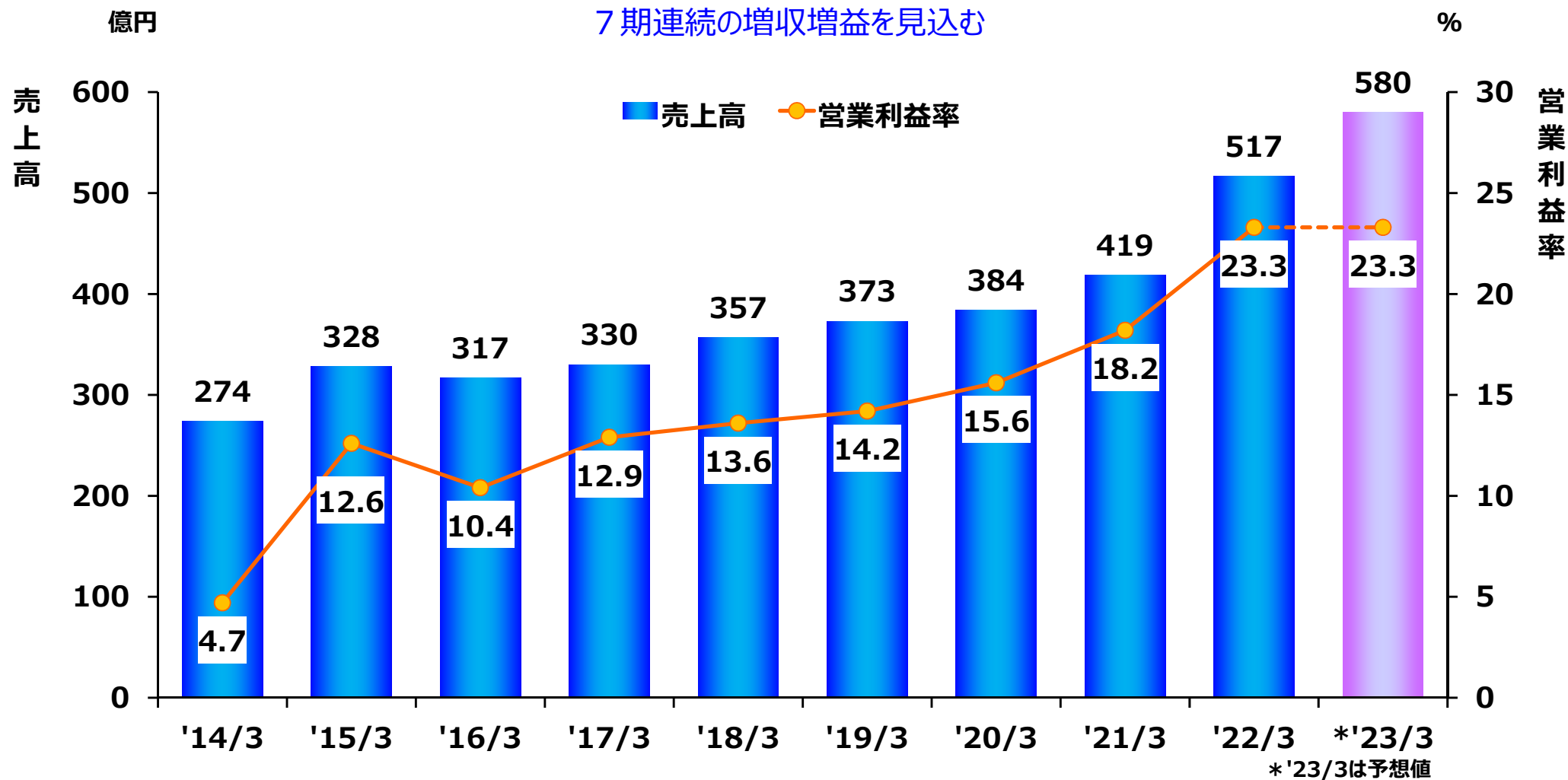
業績予想（半期）

単位：百万円	22年3月期		23年3月期					
	上期実績	下期実績	上期予想	前年同期比	前年下期比	下期予想	前年同期比	同年上期比
売上高	25,291	26,439	28,500	+12.7%	+7.8%	29,500	+11.6%	+3.5%
営業利益	6,158	5,900	6,500	+5.5%	+10.2%	7,000	+18.6%	+7.7%
率	24.4%	22.3%	22.8%	-	-	23.7%	-	-
経常利益	6,357	6,133	6,550	+3.0%	+6.8%	7,050	+14.9%	+7.6%
率	25.1%	23.2%	23.0%	-	-	23.9%	-	-
四半期純利益	4,803	4,353	4,800	△0.1%	+10.3%	5,200	+19.5%	+8.3%
率	19.0%	16.5%	16.8%	-	-	17.6%	-	-

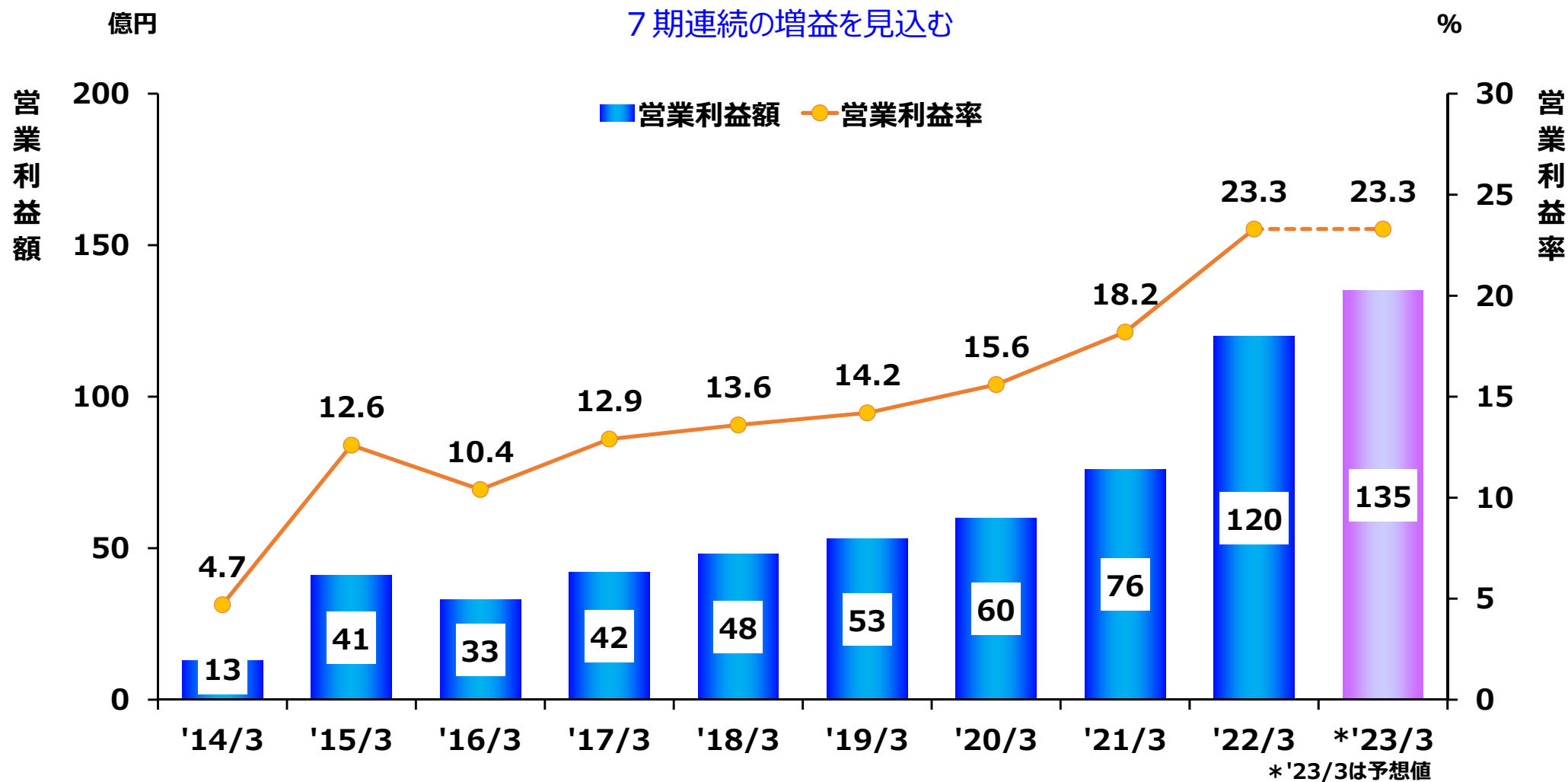
・最先端ロジック・メモリ半導体ともに、上期よりも下期に需要が強まることを想定し、下期の売上増加を見込む

業績推移（今期予想含む）

7期連続の増収増益を見込む



営業利益（今期予想含む）



用途別売上高

用途別売上高（通期実績）

単位：百万円		21年3月期	22年3月期					
		通期実績	期初予想 ('21/5)	修正予想 ('21/11)	通期実績	前期比	期初予想比 ('21/5)	修正予想比 ('21/11)
シリコンウェハー	ラッピング	4,604	4,650	6,000	6,249	+35.7%	+34.4%	+4.2%
	ポリシング	9,621	10,300	12,050	12,149	+26.3%	+18.0%	+0.8%
	切断	245	200	250	266	+8.5%	+33.1%	+6.6%
	計	14,472	15,150	18,300	18,665	+29.0%	+23.2%	+2.0%
CMP		20,037	21,000	23,700	24,571	+22.6%	+17.0%	+3.7%
ディスク	アルミディスク	1,668	1,650	1,550	1,684	+1.0%	+2.1%	+8.7%
	ガラスディスク	36	50	50	41	+12.2%	△17.3%	△17.3%
	計	1,705	1,700	1,600	1,725	+1.2%	+1.5%	+7.9%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	3,779	3,700	4,300	4,408	+16.7%	+19.2%	+2.5%
	一般工業用(非研磨材)	1,909	1,900	1,950	2,192	+14.8%	+15.3%	+12.4%
	計	5,688	5,600	6,250	6,600	+16.0%	+17.9%	+5.6%
製品売上高		41,903	43,450	49,850	51,564	+23.1%	+18.7%	+3.4%
商品売上高		52	50	150	167	+215.8%	+234.2%	+11.5%
売上高 合計		41,956	43,500	50,000	51,731	+23.3%	+18.9%	+3.5%

用途別売上高（半期実績）

単位：百万円		21年3月期		22年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	前年同期比	前年下期比	下期実績	前年同期比	同年 上期比
シリコンウェハー	ラッピング	2,158	2,446	2,985	+38.3%	+22.0%	3,264	+33.4%	+9.3%
	ポリシング	4,521	5,100	6,007	+32.9%	+17.8%	6,142	+20.4%	+2.2%
	切断	108	136	136	+25.3%	+0.0%	129	△4.9%	△4.9%
	計	6,788	7,683	9,129	+34.5%	+18.8%	9,536	+24.1%	+4.5%
CMP		10,055	9,982	12,155	+20.9%	+21.8%	12,416	+24.4%	+2.1%
ディスク	アルミディスク	926	741	770	△16.8%	+4.0%	913	+23.2%	+18.5%
	ガラスディスク	11	25	19	+75.0%	△21.5%	21	△16.0%	+7.0%
	計	938	766	790	△15.7%	+3.1%	935	+21.9%	+18.3%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	1,699	2,080	2,140	+26.0%	+2.9%	2,268	+9.0%	+5.9%
	一般工業用(非研磨材)	920	988	968	+5.2%	△2.0%	1,223	+23.7%	+26.3%
	計	2,619	3,068	3,109	+18.7%	+1.3%	3,491	+13.8%	+12.3%
製品売上高		20,401	21,501	25,185	+23.4%	+17.1%	26,379	+22.7%	+4.7%
商品売上高		25	27	106	+318.5%	+288.9%	60	+120.3%	△43.4%
売上高 合計		20,427	21,529	25,291	+23.8%	+17.5%	26,439	+22.8%	+4.5%

用途別売上高（通期予想）

単位：百万円		21年3月期	22年3月期	23年3月期	
		通期実績	通期実績	通期予想	前期比
シリコンウェハー	ラッピング	4,604	6,249	7,190	+15.0%
	ポリシング	9,621	12,149	14,100	+16.1%
	切断	245	266	260	△2.4%
	計	14,472	18,665	21,550	+15.5%
CMP		20,037	24,571	27,400	+11.5%
ディスク	アルミディスク	1,668	1,684	1,945	+15.5%
	ガラスディスク	36	41	55	+33.0%
	計	1,705	1,725	2,000	+15.9%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	3,779	4,408	4,730	+7.3%
	一般工業用(非研磨材)	1,909	2,192	2,200	+0.4%
	計	5,688	6,600	6,930	+5.0%
製品売上高		41,903	51,564	57,880	+12.2%
商品売上高		52	167	120	△28.2%
売上高 合計		41,956	51,731	58,000	+12.1%

用途別売上高（半期予想）

単位：百万円		22年3月期		23年3月期					
		上期実績	下期実績	上期予想	前年同期比	前年下期比	下期予想	前年同期比	同年上期比
シリコンウェハー	ラッピング	2,985	3,264	3,550	+18.9%	+8.8%	3,640	+11.5%	+2.5%
	ポリシング	6,007	6,142	7,020	+16.8%	+14.3%	7,080	+15.3%	+0.9%
	切断	136	129	130	△4.8%	+0.1%	130	+0.1%	+0.0%
	計	9,129	9,536	10,700	+17.2%	+12.2%	10,850	+13.8%	+1.4%
CMP		12,155	12,416	13,400	+10.2%	+7.9%	14,000	+12.8%	+4.5%
ディスク	アルミディスク	770	913	965	+25.2%	+5.6%	980	+7.2%	+1.6%
	ガラスディスク	19	21	15	△27.4%	△32.2%	40	+87.1%	+166.7%
	計	790	935	980	+23.9%	+4.8%	1,020	+9.1%	+4.1%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,140	2,268	2,310	+7.9%	+1.9%	2,420	+6.7%	+4.8%
	一般工業用(非研磨材)	968	1,223	1,050	+8.4%	△14.2%	1,150	△6.0%	+9.5%
	計	3,109	3,491	3,360	+8.1%	△3.8%	3,570	+2.3%	+6.3%
製品売上高		25,185	26,379	28,440	+12.9%	+7.8%	29,440	+11.6%	+3.5%
商品売上高		106	60	60	△43.8%	△0.8%	60	△0.8%	+0.0%
売上高 合計		25,291	26,439	28,500	+12.7%	+7.8%	29,500	+11.6%	+3.5%

シリコンウェハー売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

《通期》

単位：百万円		21年3月期	22年3月期		23年3月期	
		通期実績	通期実績	前年比	通期予想	前年比
シリコンウェハー	ラッピング	4,604	6,249	+35.7%	7,190	+15.1%
	ポリシング	9,621	12,149	+26.3%	14,100	+16.0%
	切断	245	266	+8.5%	260	△2.4%
	計	14,472	18,665	+29.0%	21,550	+15.5%

《半期》

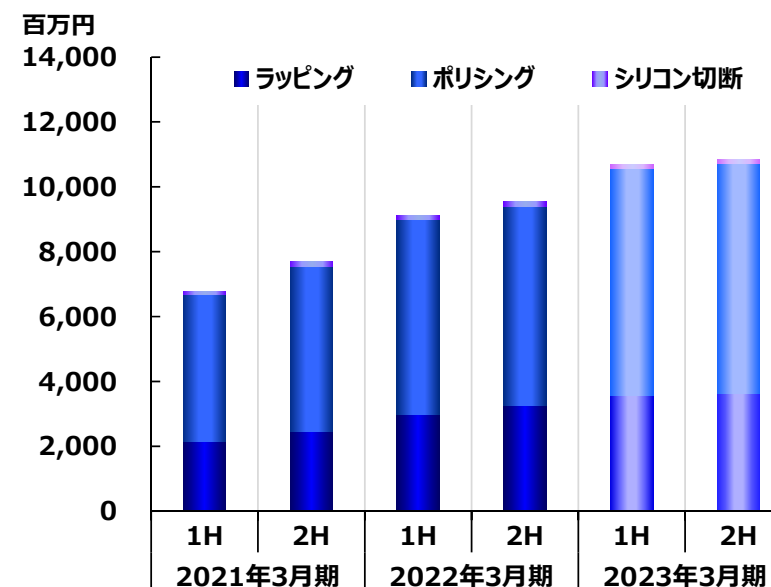
単位：百万円		21年3月期		22年3月期		23年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
シリコンウェハー	ラッピング	2,158	2,446	2,985	3,264	3,550	3,640
	ポリシング	4,521	5,100	6,007	6,142	7,020	7,080
	切断	108	136	136	129	130	130
	計	6,788	7,683	9,129	9,536	10,700	10,850

（22/3）半導体業界の高稼働により増収

ラッピング：品質有効期限が長いことから、一部で在庫積み増しあり

（23/3）半導体業界の高稼働の継続、ポリシングでは1・2研の更なるシェアアップと

ラッピングでの販売価格の上昇（値上げ含む）を想定し増収を予想



* '23/3は予想値

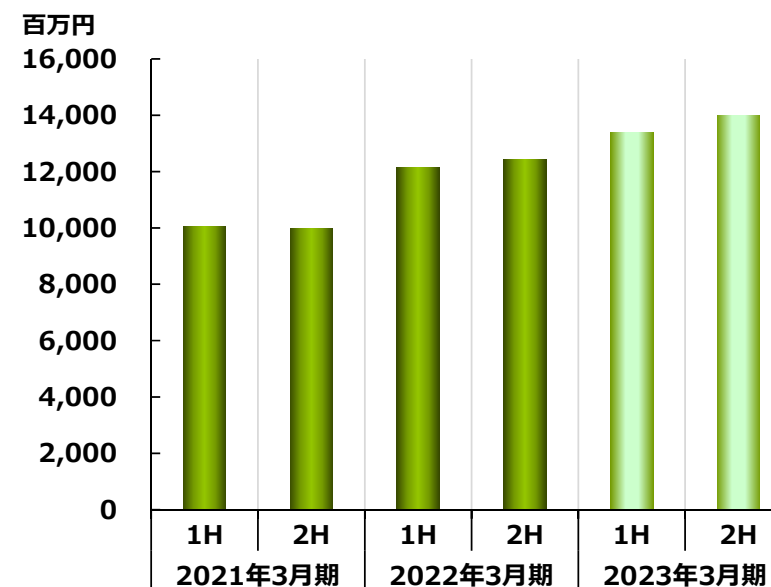
CMP売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

＜＜通期＞＞

単位：百万円	21年3月期	22年3月期		23年3月期	
	通期実績	通期実績	前年比	通期予想	前年比
CMP	20,037	24,571	+22.6%	27,400	+11.5%

＜＜半期＞＞

単位：百万円	21年3月期		22年3月期		23年3月期	
	上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
CMP	10,055	9,982	12,155	12,416	13,400	14,000



(22/3) 堅調な半導体市場に伴い、最先端半導体デバイス向けで増収
(23/3) 堅調な半導体市場の継続、為替の影響を想定し増収を予想

* '23/3は予想値

ディスク売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

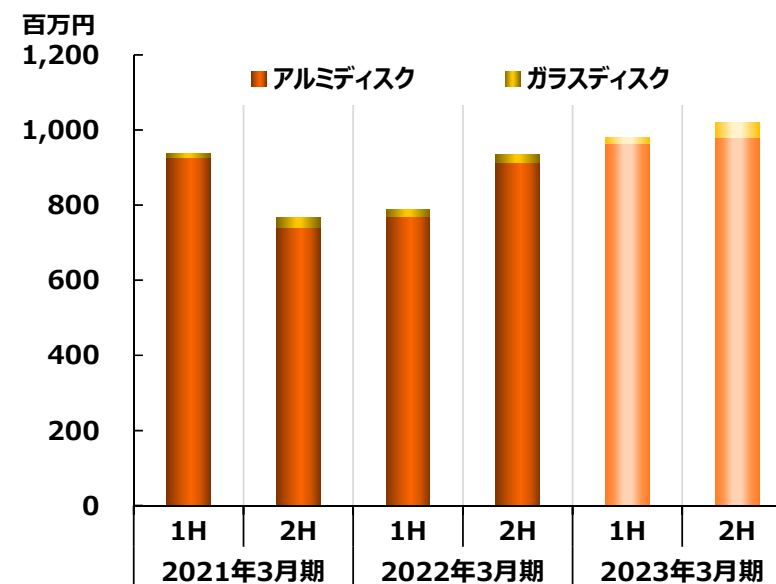
《通期》

単位：百万円		21年3月期	22年3月期		23年3月期	
		通期実績	通期実績	前年比	通期予想	前年比
ディスク	アルミディスク	1,668	1,684	+1.0%	1,945	+15.5%
	ガラスディスク	36	41	+12.2%	55	+33.0%
	計	1,705	1,725	+1.2%	2,000	+15.9%

《半期》

単位：百万円		21年3月期		22年3月期		23年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
ディスク	アルミディスク	926	741	770	913	965	980
	ガラスディスク	11	25	19	21	15	40
	計	938	766	790	935	980	1,020

（22/3）市場縮小と一部顧客の事業撤退に伴う生産終了の影響あるも、前年並み
（23/3）コロナ禍収束後の顧客生産復調による増収を予想



* '23/3は予想値

機能材・溶射材売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

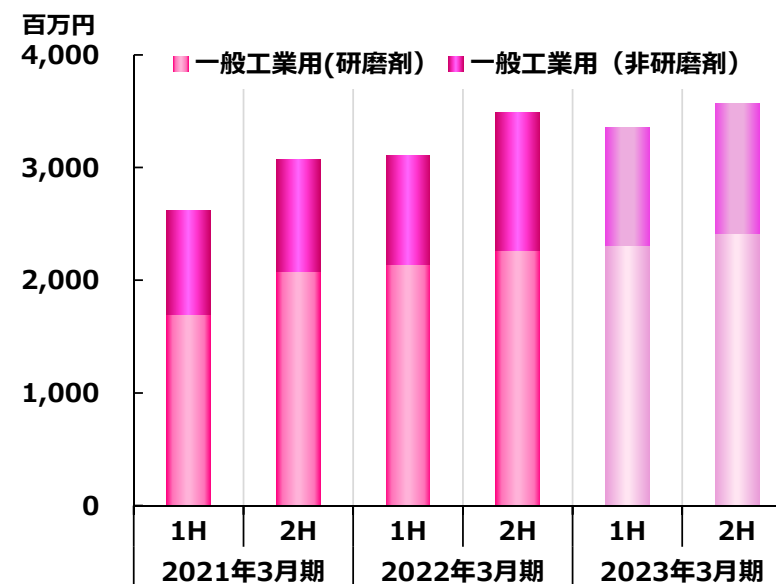
《通期》

単位：百万円		21年3月期	22年3月期		23年3月期	
		通期実績	通期実績	前年比	通期予想	前年比
機能材・溶射材	一般工業用（研磨材）	3,779	4,408	+16.7%	4,730	+7.3%
	一般工業用（非研磨材）	1,909	2,192	+14.8%	2,200	+0.4%
	計	5,688	6,600	+16.0%	6,930	+5.0%

《半期》

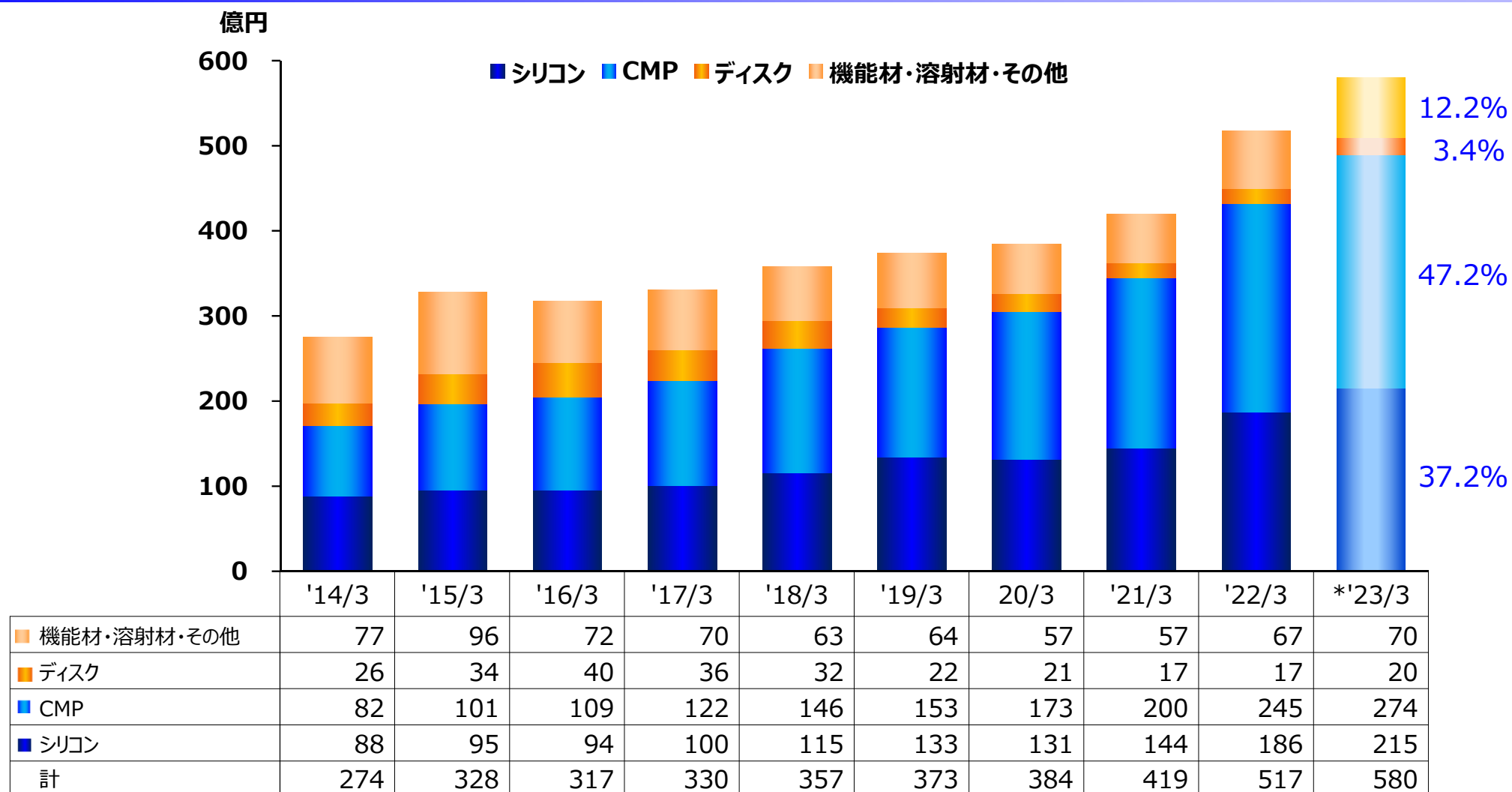
単位：百万円		21年3月期		22年3月期		23年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
機能材・溶射材	一般工業用（研磨材）	1,699	2,080	2,140	2,268	2,310	2,420
	一般工業用（非研磨材）	920	988	968	1,223	1,050	1,150
	計	2,619	3,068	3,109	3,491	3,360	3,570

【研磨材】（22/3）自動車及び産業機械向け需要の回復もあり増収
 【〃以外】（22/3）半導体装置向け溶射材で増収
 （23/3）触媒担体向け機能性材で減収も、
 半導体装置向け溶射材増収で前年並みを予想

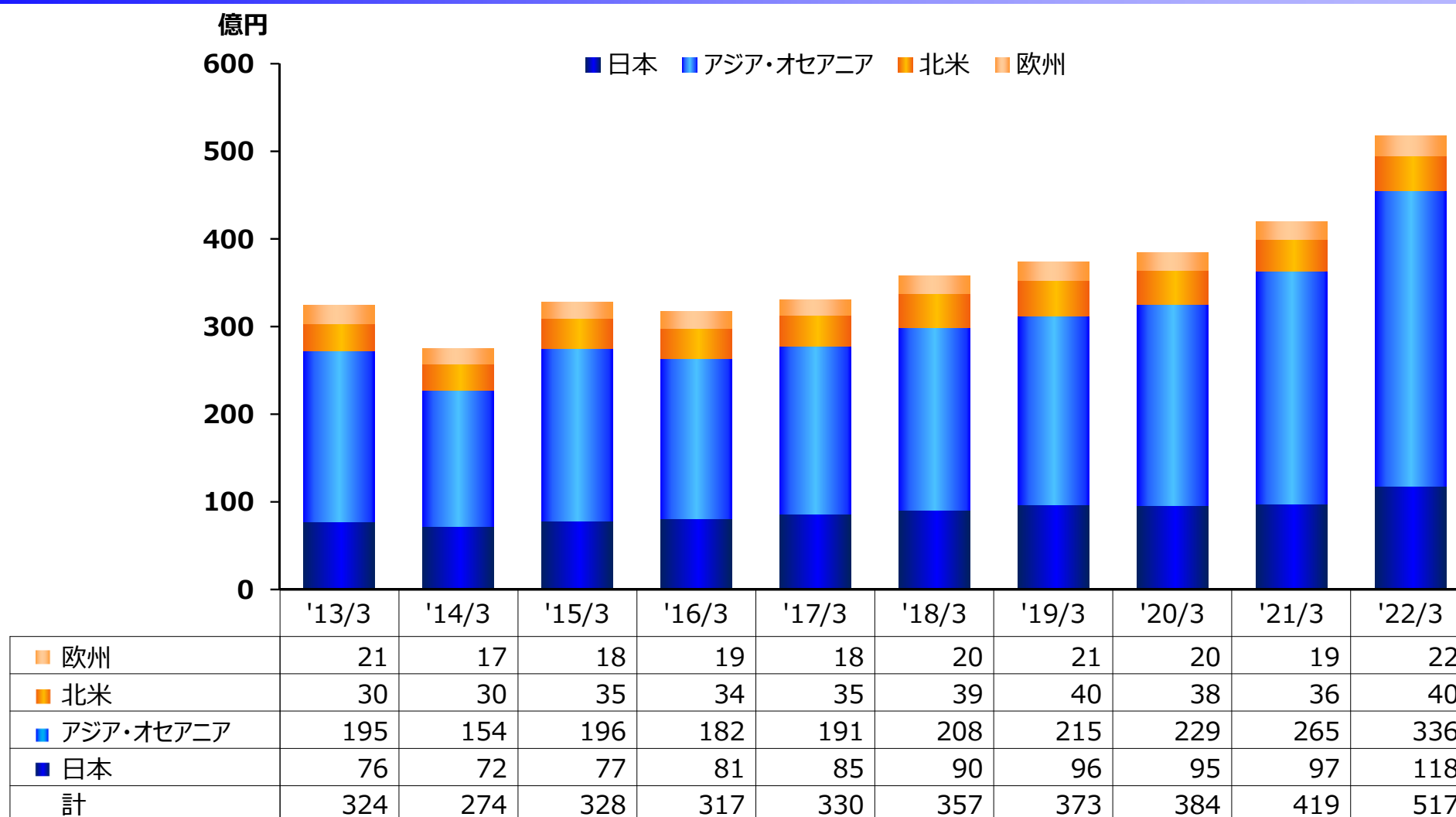


* '23/3は予想値

用途別売上高（通期）



地域別売上高（通期 仕向先別）

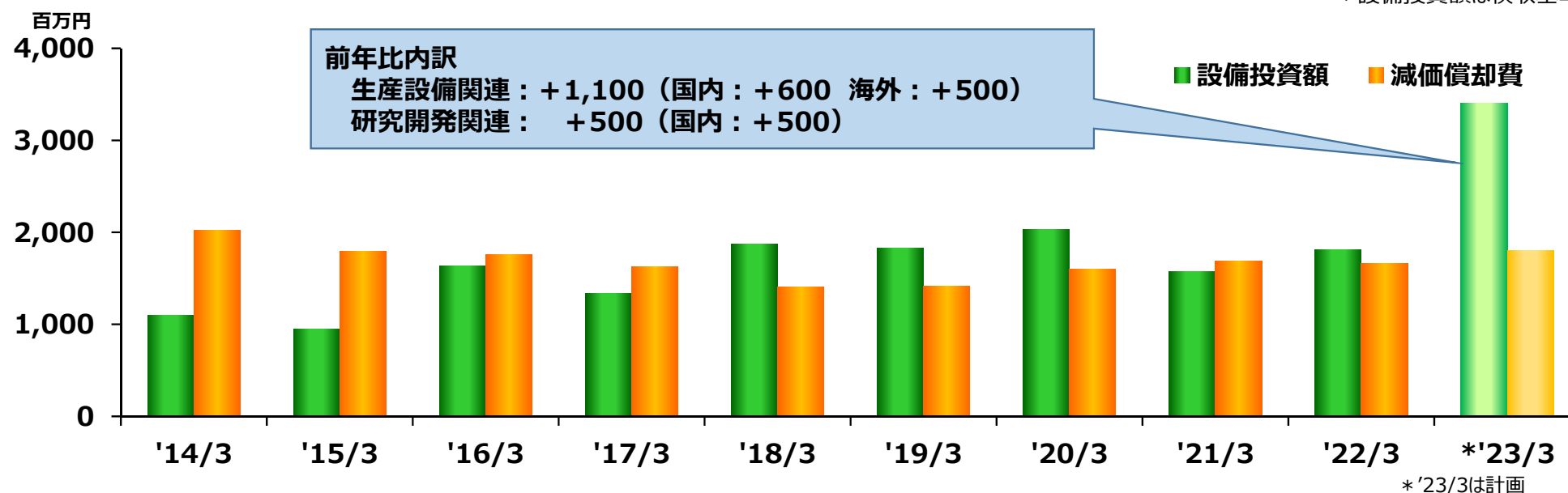


設備投資額 減価償却費 研究開発費

設備投資額・減価償却費（通期実績・通期計画）

単位：百万円	21年3月期	22年3月期						23年3月期	
	通期実績	期初計画	修正計画	通期実績	前年比	期初計画比	修正計画比	通期計画	前年比
設備投資額	1,574	1,800	2,300	1,814	+15.3%	+0.8%	△21.1%	3,400	+87.4%
減価償却費	1,687	1,650	1,700	1,661	△1.5%	+0.7%	△2.3%	1,800	+8.3%

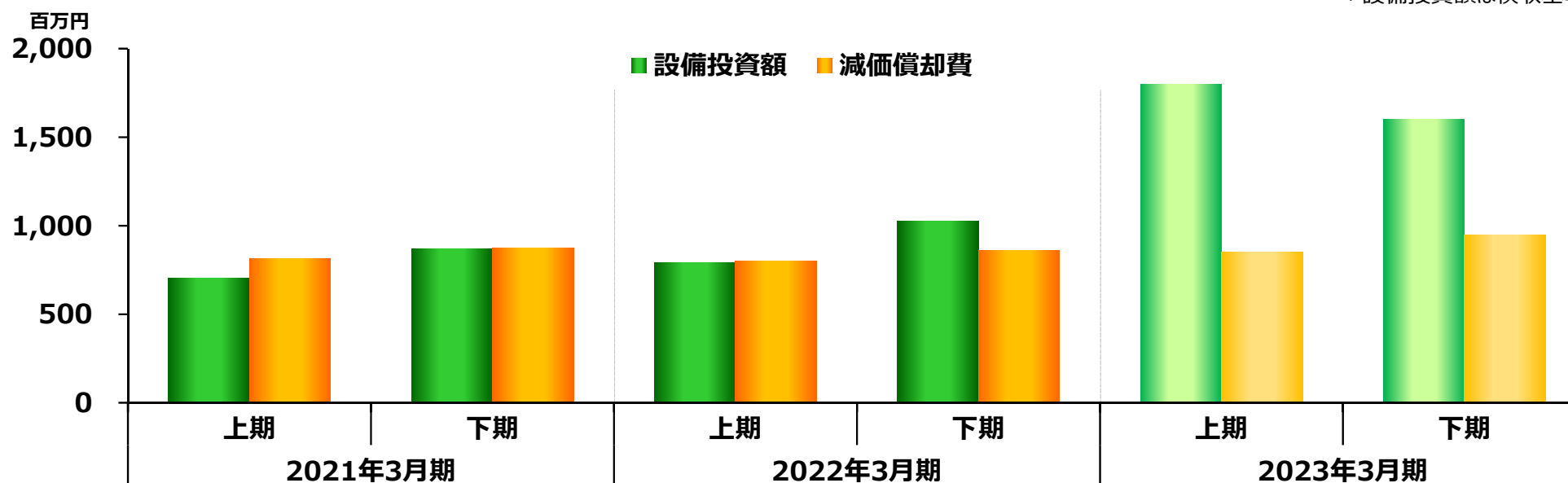
* 設備投資額は検収基準



設備投資額・減価償却費（半期実績・半期計画）

単位：百万円	21年3月期		22年3月期				23年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	前年同期比	同年上期比	上期計画	前年同期比	前年下期比	下期計画	前年同期比	同年上期比
設備投資額	704	870	789	1,024	+17.8%	+29.8%	1,800	+128.0%	+75.6%	1,600	+56.1%	△11.1%
減価償却費	815	872	802	859	△1.5%	+7.1%	850	+5.9%	△1.1%	950	+10.5%	+11.8%

* 設備投資額は検収基準



中期的な設備投資計画

- ・ 半導体市場の旺盛な需要に応える生産設備投資
- ・ 先端半導体向け製品に対して高まる品質要求に応える研究開発及び品質保証関連投資

各務山新工場建設（計画）

敷地面積：28千㎡

昨年12月に売買契約を締結

- ・ シリコン、CMP製品の生産能力増強

FUJIMI CORPORATION（米国）

既存工場敷地内に新棟建設を計画

- ・ CMP生産スペース拡大

FUJIMI TAIWAN（台湾）

- ・ 建屋増築は既に完了、順次CMP生産設備の導入を計画

- ・ 中期視点での研究開発と新規事業の探索・育成のための投資

第2開発センター（仮称）建設（計画）

敷地面積：16千㎡

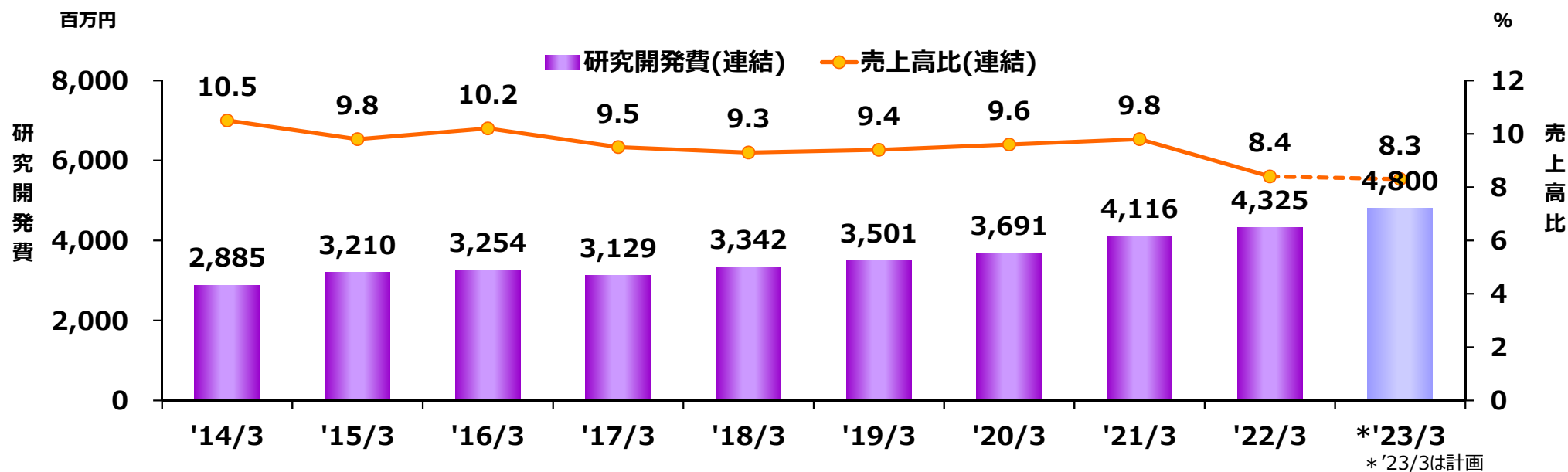
現研究開発センター近隣の岐阜県テクノプラザ内に用地取得済

- ・ 非半導体関連の研究施設を設置



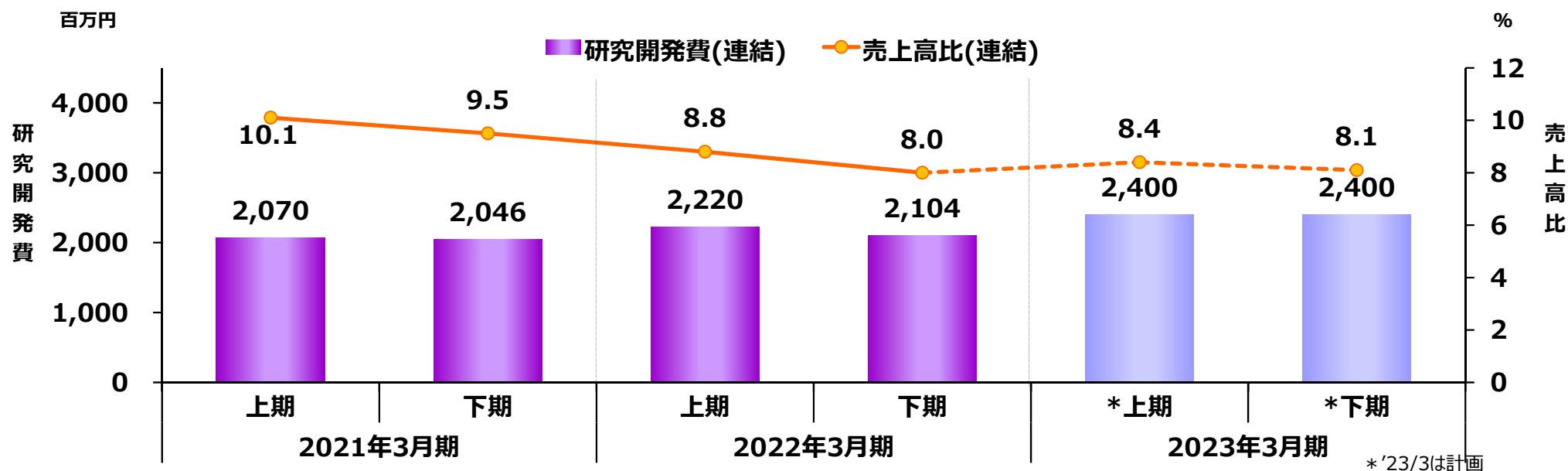
研究開発費／売上高比（通期実績・通期計画）

単位：百万円	21年3月期	22年3月期						23年3月期	
	通期実績	通期計画	修正計画	通期実績				通期計画	前年比
					前期比	期初計画比	修正計画比		
研究開発費	4,116	4,200	4,400	4,325	+5.1%	+3.0%	△1.7%	4,800	+11.0%



研究開発費／売上高比（半期実績・半期計画）

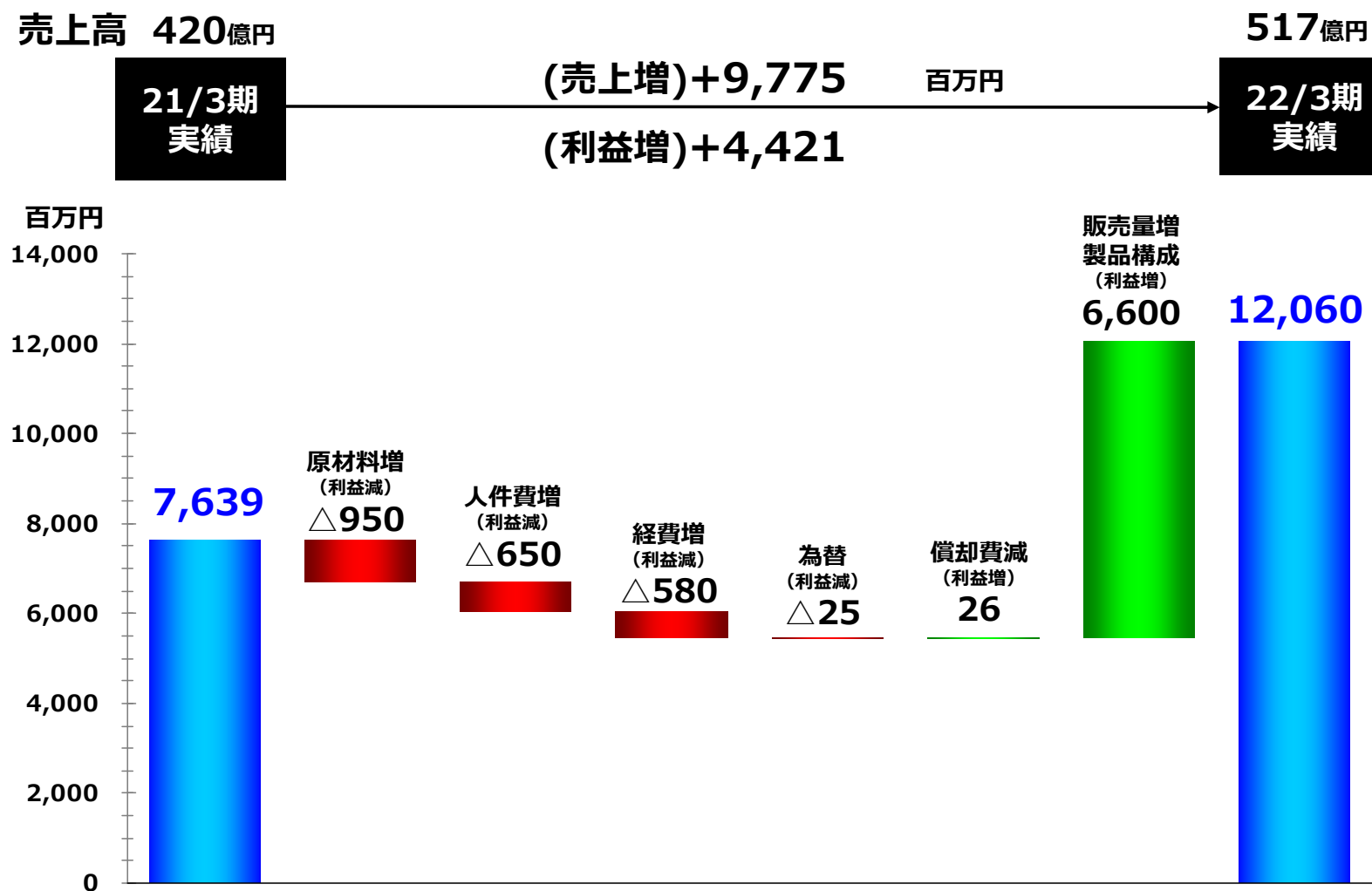
単位：百万円	21年3月期		22年3月期				23年3月期					
	上期 実績	下期 実績	上期 実績	下期 実績	前年 同期比		上期 計画	前年 同期比	前年 下期比	下期 計画	前年 同期比	同年 上期比
研究開発費	2,070	2,046	2,220	2,104	+2.8%	△5.3%	2,400	+8.1%	+14.1%	2,400	+14.1%	+0.0%



損益分析

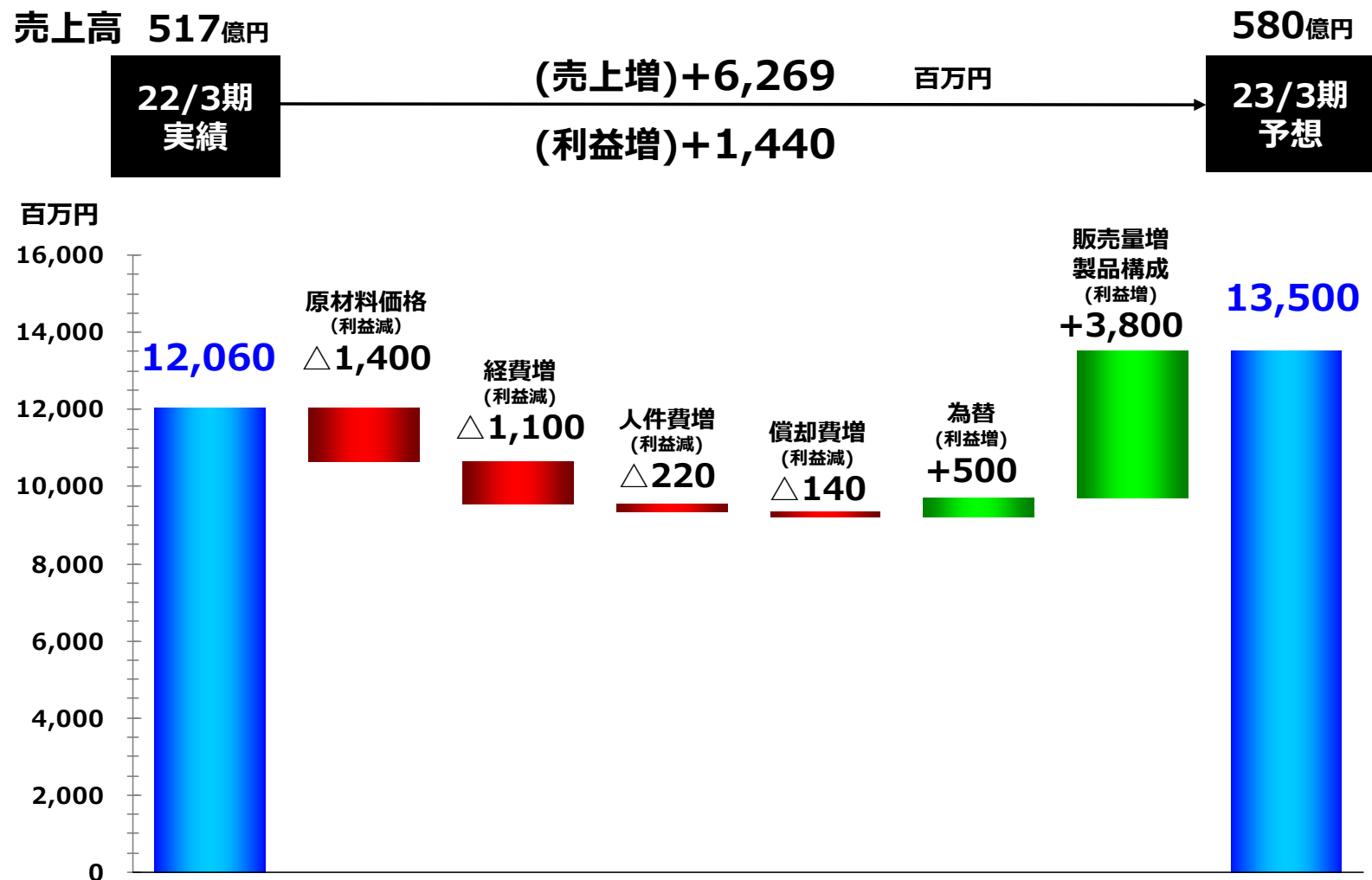
営業利益増減要因

21/3期実績→22/3期実績



営業利益増減要因

22/3期実績→23/3期予想



株主還元

積極的な株主還元と安定配当の継続

■ 利益配分に関する基本方針

1. 目標：連結配当性向 50%以上
2. 安定配当の継続

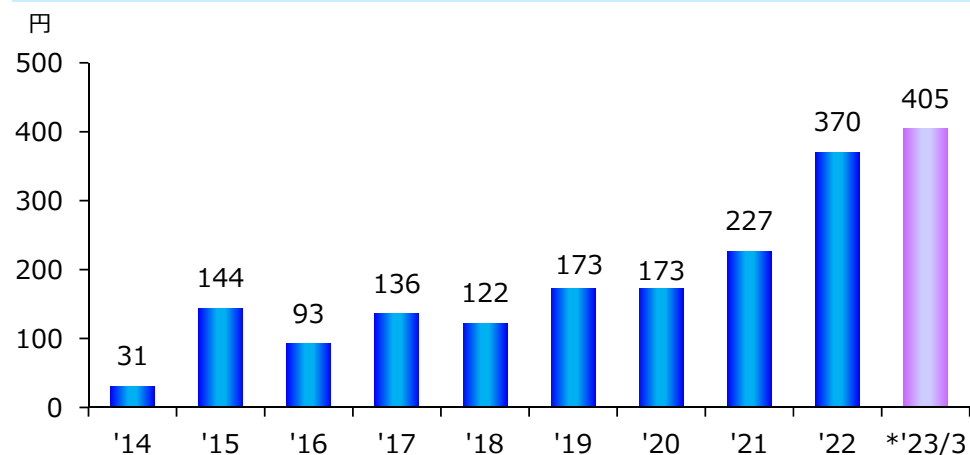
■ 1株当たり配当金

	2020/3月期		2021/3月期		2022/3月期	
	期初予想 2019/5/10	実績 2020/5/13	予想* 2020/11/4	実績 2021/5/12	期初予想 2021/5/12	実績 2022/5/31
中間配当金	40円	40円	50円	50円	60円	85円
期末配当金	40円	47円	50円	65円	65円	100円
年間配当金	80円	87円	100円	115円	125円	185円
配当性向	54.9%	50.3%	47.5%	50.7%	49.8%	49.9%

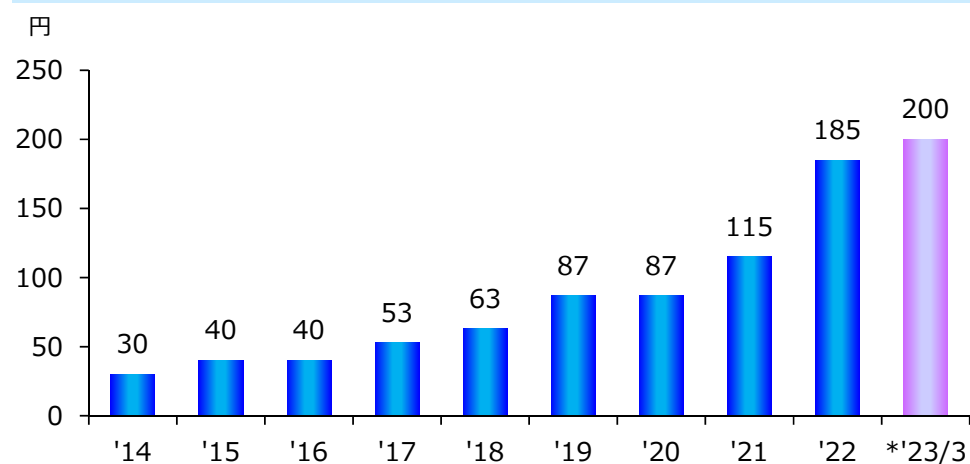
*2021/3月期の期初予想はコロナ影響により未定とした。

積極的な株主還元と安定配当の継続

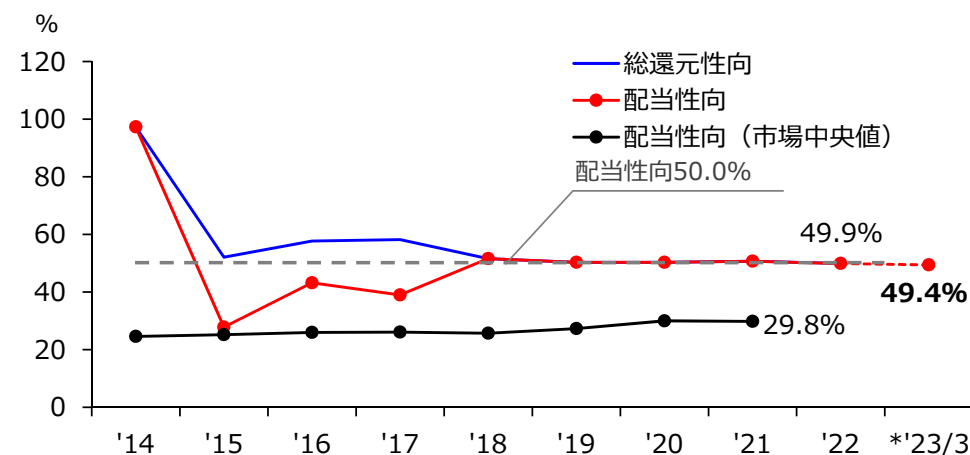
1 株当たり当期純利益



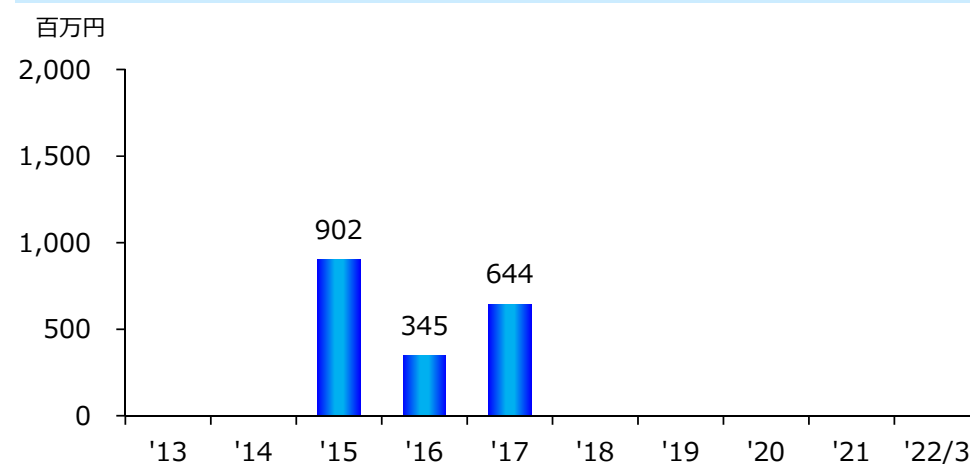
1 株当たり配当金



総還元性向・配当性向



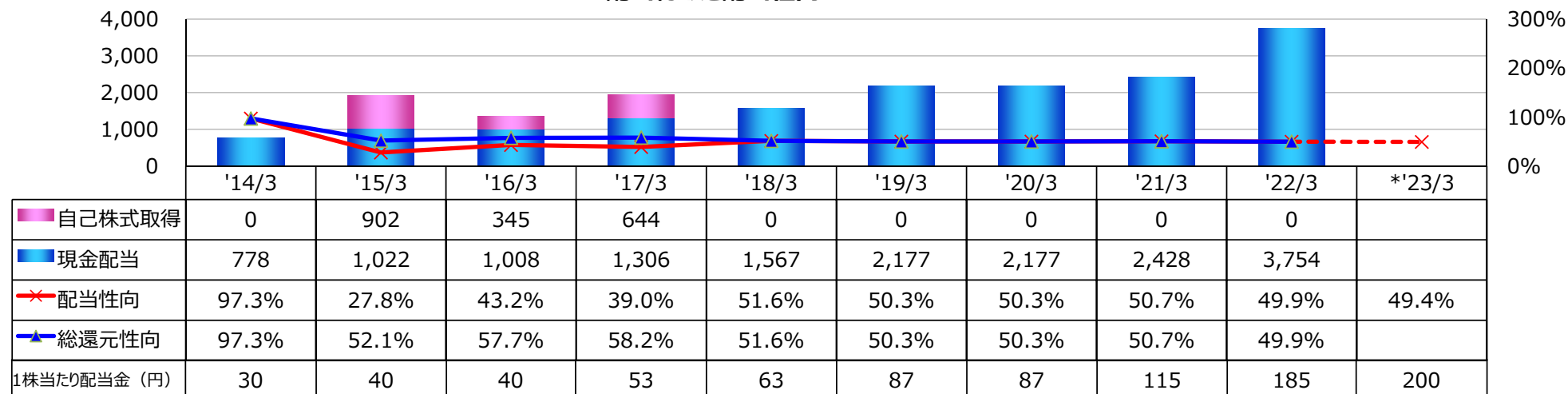
自己株買い



*'23/3は計画

積極的な株主還元と安定配当の継続

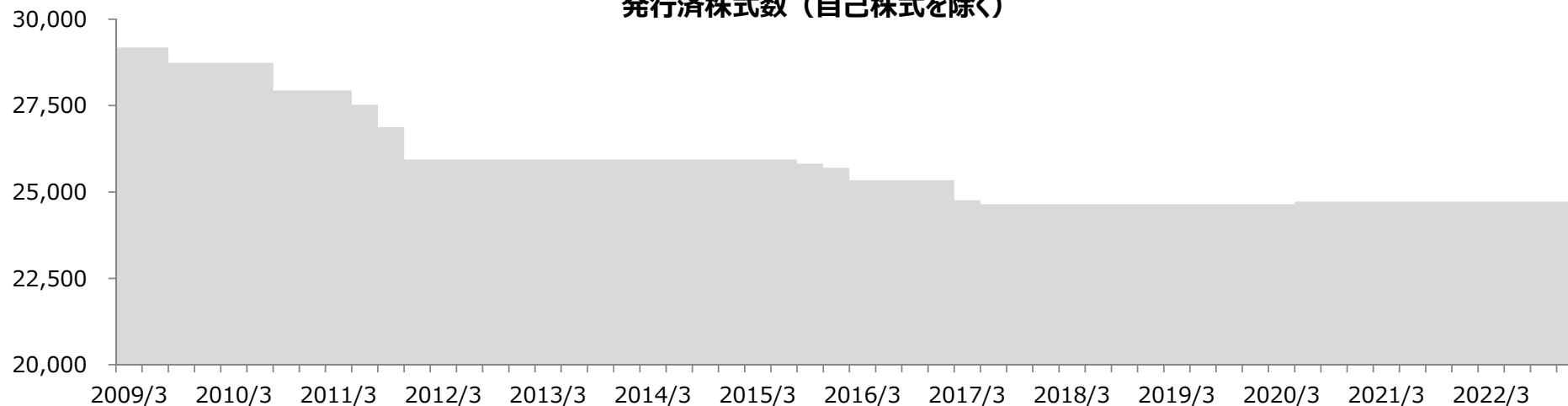
配当総額と配当性向



*'23/3は予想値

(千株)

発行済株式数（自己株式を除く）



2022年3月期 業績サマリー／2023年3月期 業績予想

【2022年3月期 業績サマリー】

✓ 売上高	+23.3%*	: 最先端半導体デバイス向けCMP製品・シリコンウェハー向け製品の販売が好調 過去最高を更新
✓ 営業利益	+57.9%	: 最先端半導体関連製品の売上増加に加え、製品構成が良化
✓ 経常利益	+62.0%	:
✓ 四半期純利益	+63.3%	: 営業利益、経常利益は3期、四半期純利益は4期連続過去最高を更新
✓ シリコンウェハー向け	+29.0%	: 半導体業界の高稼働によりラッピング・ポリシングは大幅増
✓ CMP向け	+22.6%	: メモリ・ロジックともに最先端向け製品の販売増加
✓ ハードディスク向け	+1.2%	:
✓ 一般工業用向け	+16.0%	: 自動車及び産業機械向け需要の回復もあり増収
✓ 株主還元		: 前年比70円増配（60%増）の一株当たり年間配当金185円

【2023年3月期 業績予想】

✓ 売上高	+12.1%	: 最先端半導体関連製品の販売増加で 2期連続の過去最高を見込む
✓ 営業利益	+11.9%	: 増収に伴い増益となるも、経費増・原材料価格高騰により、営業利益率は前期水準（23.3%）を維持
✓ 経常利益	+8.9%	:
✓ 当期純利益	+9.2%	: 営業利益・経常利益・当期純利益ともに4期連続となる過去最高を見込む

*前期比

Copyright(c) 2022 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

中長期経営計画

第6次（2017/3期～2022/3期）中長期経営計画 主要KPI計画・実績対比

	計画初年度 (2017/3期)	最終年度（2022/3期）	
	実績	計画	実績
連結売上高	330億円 半導体：200億円 非半導体：100億円	600億円 半導体：330億円 非半導体：270億円	517億円（未達） 半導体：440億円 非半導体：78億円
連結営業利益率 （参考）額	12.9% (42億円)	15%以上 (90億円)	23.3%（達成） (120億円)
新規事業売上構成比	4% 13億円	25%以上 150億円	2%（未達） 9億円
ROE	7.4%	10%以上	15.4%（達成）
配当性向	39%	50%以上 ※2019/3期を目途に	49.9% ※2018/3期に50%以上 （概ね達成）

- 収益性の高い最先端半導体向け製品の売上が伸長したことから、営業利益、ROEは目標を達成
- 新規事業分野においては、加工プロセス変更による研磨ニーズの縮小、その他新規開発分野においても開発品の採用に時間を要したことから、連結売上高、新事業売上構成比は目標未達

本年5月の公表を旨とし策定を進めてきた次期中長期経営計画の公表延期

- サイバー攻撃により、計画の策定作業を中断
- 新型コロナウイルスは依然として世界経済に影響
- 米中間の緊張、ロシア・ウクライナ情勢等、国際社会の分断は一層深刻化
- 資源・エネルギー価格の高騰（それによる物価上昇）
- 世界的な物流混乱

→ 現時点では合理的な業績計画立案の前提に不確実性が増しており
再検討必要なため

補足資料

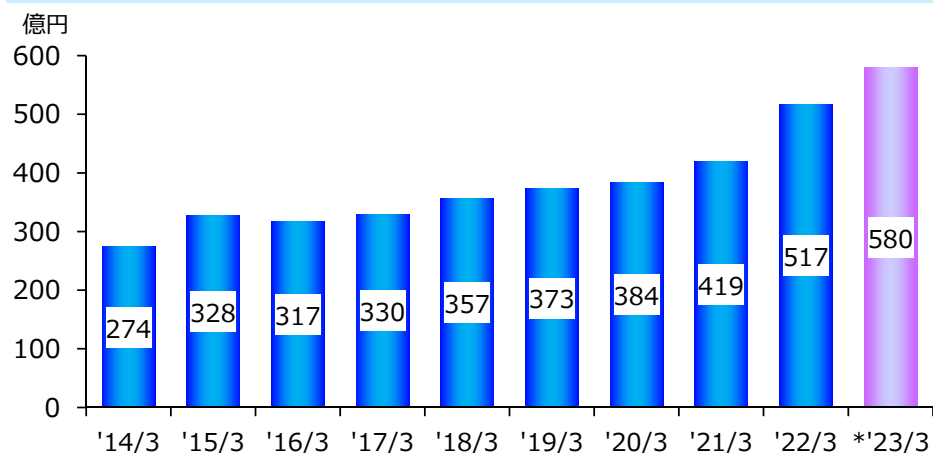
グループ人員 内訳

(人数)	21年3月期 (3月31日現在)		22年3月期 (3月31日現在)			
	正社員	臨時雇用者*	正社員	臨時雇用者*	前期末増減	
					正社員	臨時雇用者
フジミインコーポレーテッド	670	187	693	216	+23	+29
フジミコーポレーション	117	2	118	3	+1	+1
フジミ台湾	91	2	95	2	+4	—
フジミマイクロテクノロジー	69	4	67	5	△2	+1
フジミヨーロッパ	5	2	4	2	△1	—
フジミ韓国	4	1	0	0	△4	△1
フジミ深圳	2	1	3	1	+1	—
合 計	958	199	980	229	+22	+30

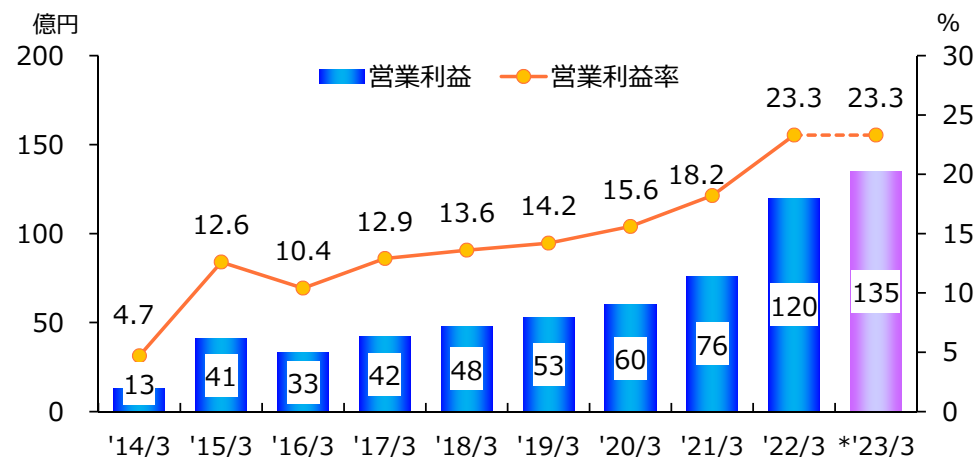
* 臨時雇用者（嘱託、パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は年間の平均人員

業績推移（通期）

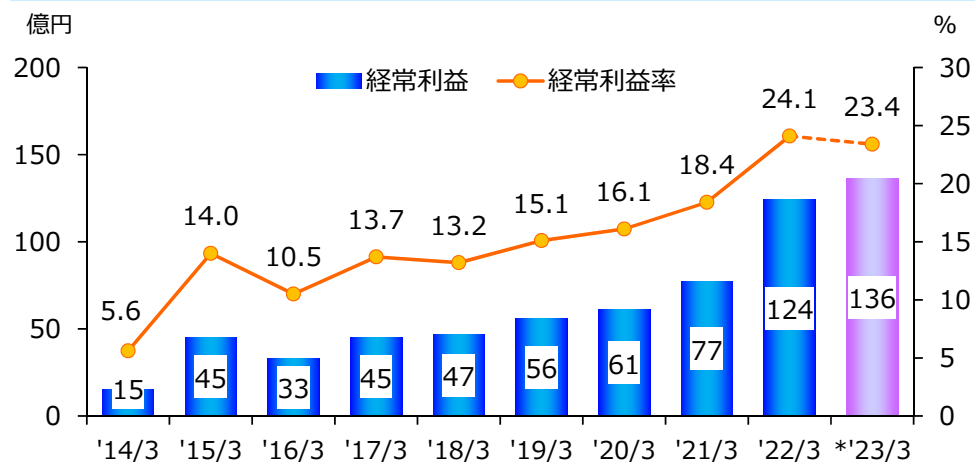
売上高



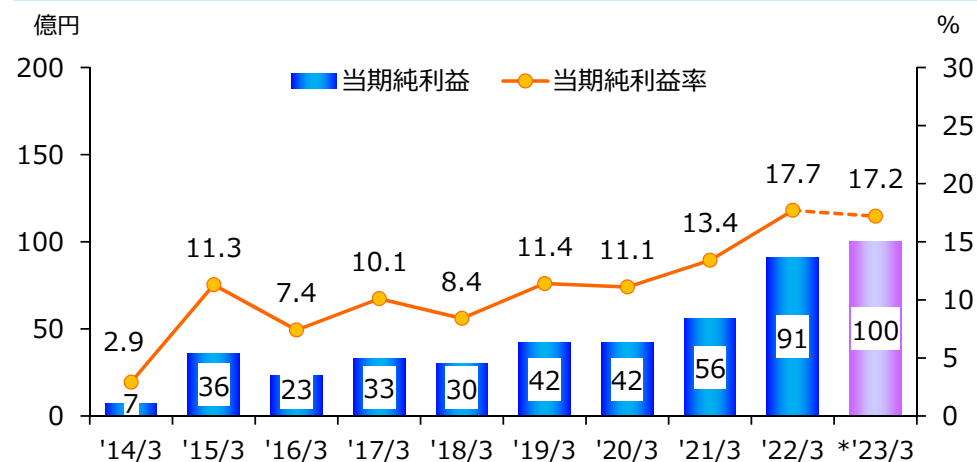
営業利益



経常利益

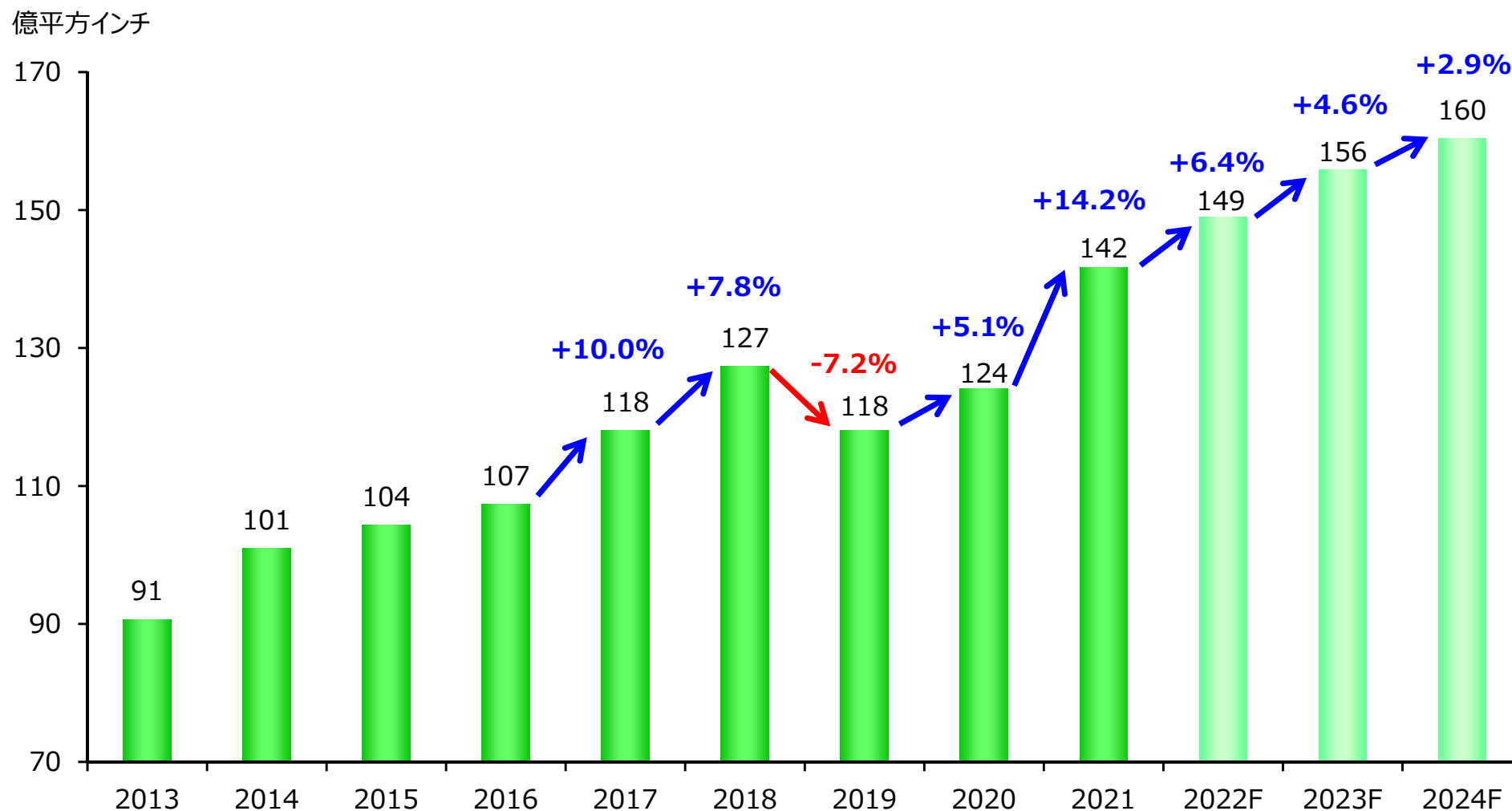


当期純利益



*'23/3は予想値

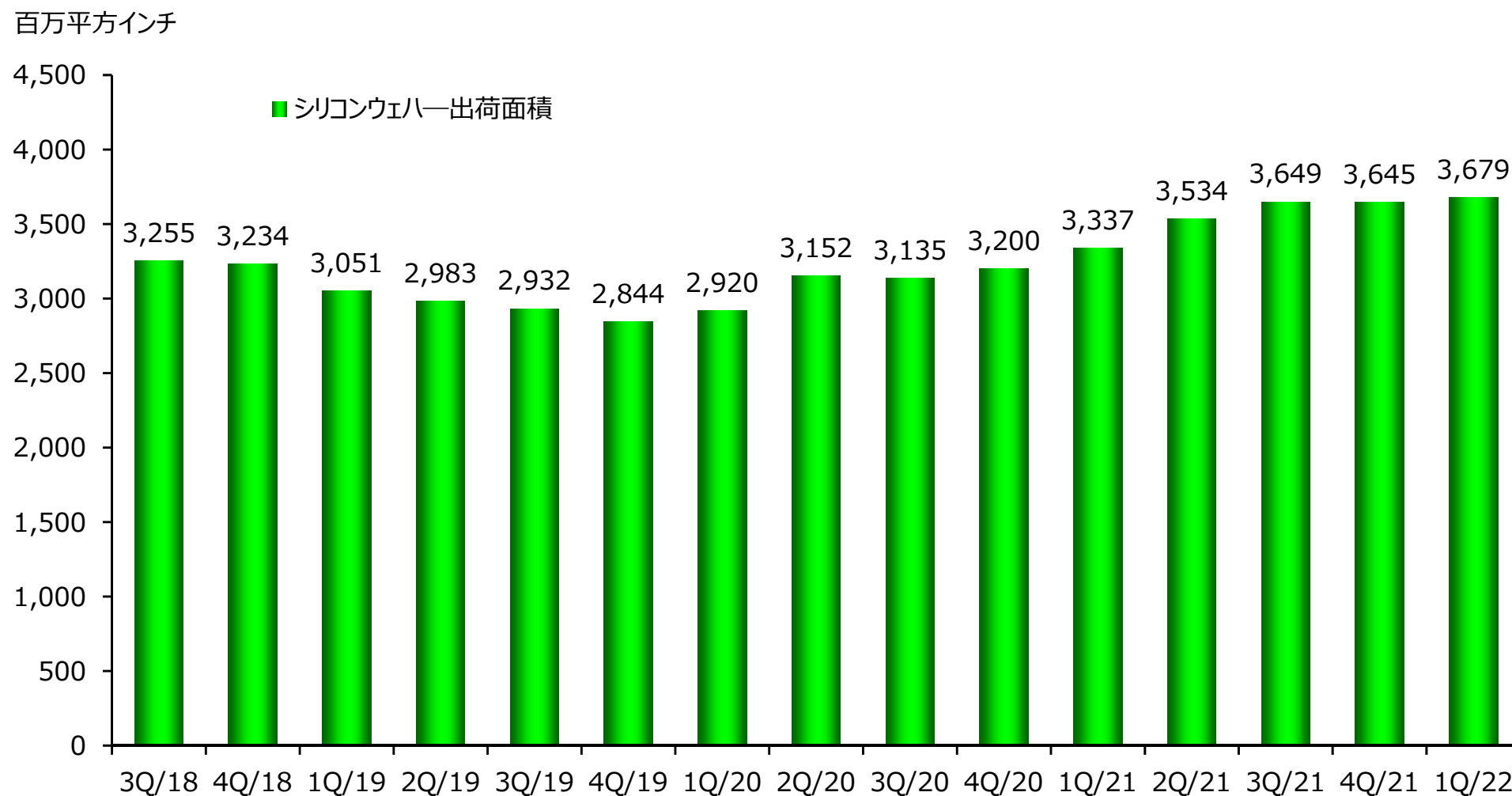
シリコンウェハー需要予測（出荷面積換算 全口径）



出所：SEMI（実績 2022/2/22 予測 2021/10/20）

Copyright(c) 2022 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

シリコンウェハー出荷面積（四半期）

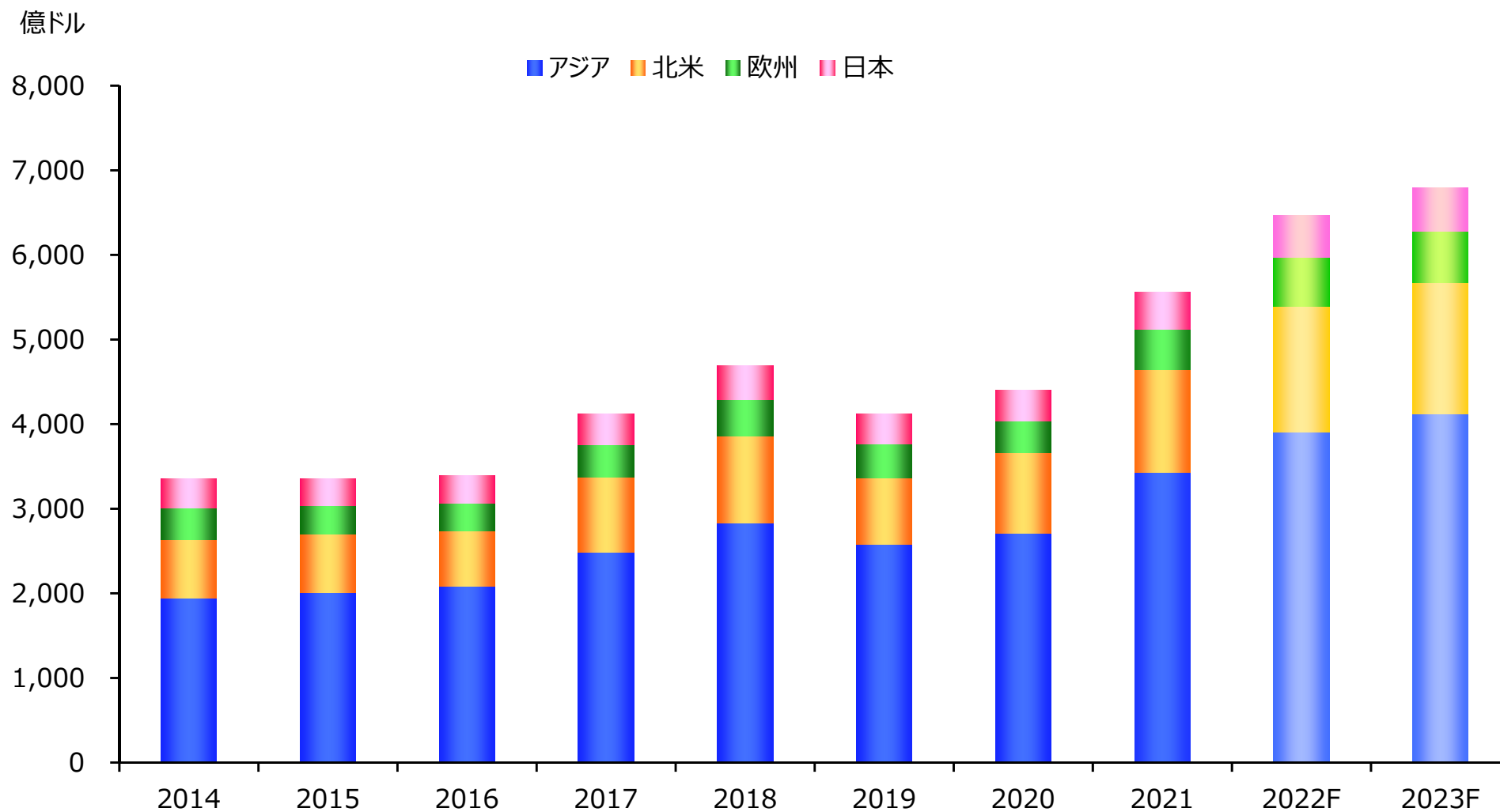


出所： SEMI (2022/5/9)

《暦年ベース》

Copyright(c) 2022 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

半導体市場規模（地域別）



出所：WSTS（2022/6/7）

Copyright(c) 2022 Fujimi Incorporated. All rights reserved.